

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 登録実用新案公報(U)

(11) 実用新案登録番号

実用新案登録第3156732号
(U3156732)

(45) 発行日 平成22年1月14日(2010.1.14)

(24) 登録日 平成21年12月16日(2009.12.16)

(51) Int. Cl. F 1
H 0 1 L 33/64 (2010.01) H 0 1 L 33/00 4 5 0

評価書の請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 8 頁)

<p>(21) 出願番号 実願2009-7717 (U2009-7717) (22) 出願日 平成21年10月29日(2009.10.29)</p>	<p>(73) 実用新案権者 509299215 柏友照明科技股▲フン▼有限公司 台湾桃園縣▲亀▼山郷科技二路37巷37 號 (74) 代理人 100108453 弁理士 村山 靖彦 (74) 代理人 100064908 弁理士 志賀 正武 (74) 代理人 100089037 弁理士 渡邊 隆 (74) 代理人 100110364 弁理士 実広 信哉 (72) 考案者 ▲呉▼ 朝欽 台湾台北市文山區興隆路二段244巷6號 2樓</p>
--	--

最終頁に続く

(54) 【考案の名称】 リフローによる半田付けが可能で且つ放熱効果を高める LED のパッケージ構造

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 リフローによる半田付けが可能で且つ放熱効果
を高める LED のパッケージ構造を提供する。

【解決手段】 基板ユニット 1、発光ユニット 2、導電
ユニット W 及びパッケージユニット 4 を含む。基板ユニ
ット 1 の基板本体 10 は、上表面に正極導電はんだパッド
11 a と負極導電はんだパッド 11 b を有する。発光ユ
ニット 2 は、底部にニッケル/パラジウム/金層を有す
る固化したはんだボール又ははんだペースト B によっ
て基板本体 10 の上に位置決めされた LED ダイス 20
を有する。導電ユニット W の 2 本の導線 Wa は LED
ダイス 20 を正極導電はんだパッド 11 a と負極導電
はんだパッド 11 b の間に電氣的に接続する。パッケ
ージユニット 4 は基板本体 10 の上表面に成形して発
光ユニット 2 と導電ユニット W を覆う透明パッケ
ージコロイド 40 を有する。

【選択図】 図 1

